

真空プラズマ装置 V10-G

フォトレジスト膜剥離処理に特化したプラズマ処理機



真空プラズマ製造装置 V10-Gはスライドドアとクォーツガラス製のプラズマ炉を持ち、半導体ウエファの洗浄に最適な物となっています。

バッチ型装置V10-Gはフォトレジスト膜剥離処理に対し最適設計されたものです。装置はまた、半導体ウエファの洗浄用途に最適な物となっています。

応用例

- 高容量注入工程後およびRIEやイオンビームエッチングなどのドライプロセス後でのフォトレジスト膜（及びSU-8）剥離処理
- バラッキ低減や効果の改善の為に、ウエットプロセスの前にシリコンウエファや他の基板に対して行う濡れ性の改良作業等
- MEMSやナノテクノロジーなどのプロセスにおける応用
- 高分子ポリマ膜の除去 例：ボッシュプロセス後の処理
- 有機犠牲層の除去
- 生体活性物質の調整

システム概要

- プラズマ炉：クォーツガラス
- スライドドア
- 中央制御装置：SPS (S7-300)
- 抵抗膜方式タッチパネル付きWindowsオペレーティングシステム(手袋をしたまま操作が可能)
- 自動及びマニュアル動作モード
- 関連する全てのプロセスパラメータの表示
- ユーザーグループごとの個別アクセス許可
- すべての実行プロセスの履歴保存
- 遠隔メンテナンス作業（VPN経由）
- LAN接続（イーサネット）

オプション

- 真空ポンプ
- オゾン用フィルタ
- 最大2個まで追加ガス入力が可能（標準オプション）
- ソフトスタートとソフト復圧
- 電磁シールド
- プロセス圧調整弁

技術データ

システム寸法 (W x D x H): 720 x 820 x 820 mm

プラズマ炉寸法 (Ø x D): 215 x 260 mm

プラズマ励起周波数: マイクロ波 (2.45 GHz)

マイクロ波出力: 50-600 W

流量制御付きガス入力口: 1 プロセスガス入力

電源: 400 V, 50/60 Hz

入力電力 (真空ポンプなし): 1.5 kVA

真空計方式: ピラニ型

重量: 150 kg

ピンク・ジャパン株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋 5-25-3

第2一松ビル 1F

電話(オフィス): 03-5777-0602

ファックス: 03-5777-0604

info@pink-japan.co.jp

www.pink-japan.co.jp

PiNK GmbH Thermosysteme

Am Kessler 6

97877 Wertheim, Germany

T +49 (0) 93 42 919-0

F +49 (0) 93 42 919-111

plasma-finish@pink.de

www.pink.de

